

삼성전자가 반도체 매출로 2년 만에 대만 반도체기업 TSMC를 제쳤다. 글로벌 업계의 관심을 모았던 5세대 고대역폭메모리 (HBM) 'HBM3E' 8단과 12단 제품도 엔비디아, AMD를 비롯한 주요 인공지능(AI) 반도체 기업 공급이 임박했다는 분석이 나온다.

삼성전자는 2분기(4~6월) 연결 기준 매출 74조700억 원, 영업이익 10조4400억 원을 기록했다고 31일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 23% 올랐고 영업이익은 16배 이상 늘어난 수치다.

삼성전자의 어닝 서프라이즈는 AI발 반도체 훈풍 덕을 톡톡히 봤다. DS(반도체) 부문의 2분기 매출은 전년 동기 대비 94% 급등한 28조5600억 원 을 기록했다. 이는 앞서 발표된 대만 파운드리(반도체 위탁생산) TSMC의 2분기 매출 6735억1000만 대만 달러(약 28조3000억 원)를 넘어선 것이다. 삼성전자 반도체 부문 매출은 2022년 2분기 이래 TSMC에 계속 뒤처져 오다 이번 분기 역전에 성공했다. DS부문 영업이익도 6조4500억 원으로 전년 동기 보다 10조 원 이상 뛰었다.

삼성전자는 HBM 사업과 관련한 로드맵도 내놔다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 실적 발표 컨퍼런스콜에서 현재 엔비디아 등이 쉘 테스트(품질 검증)를 진행 중인 HBM3E에 대해 "8단 제품은 3분기(7~9월) 중, 12단은 하반기(7~12월) 중 공급을 본격화할 예정"이라고 말했다. 하반기 엔비디아 공급이 가시화 됐음을 시사한 것이다. 또 "최근 기준으로 올해 고객사 (공급) 협의 완료된 물량은 전년 대비 4배 가까운 수준"이라며 "내년에는 올해 대비 2배가 넘는 공급량 확대를 계획 중"이라고 밝혔다.